

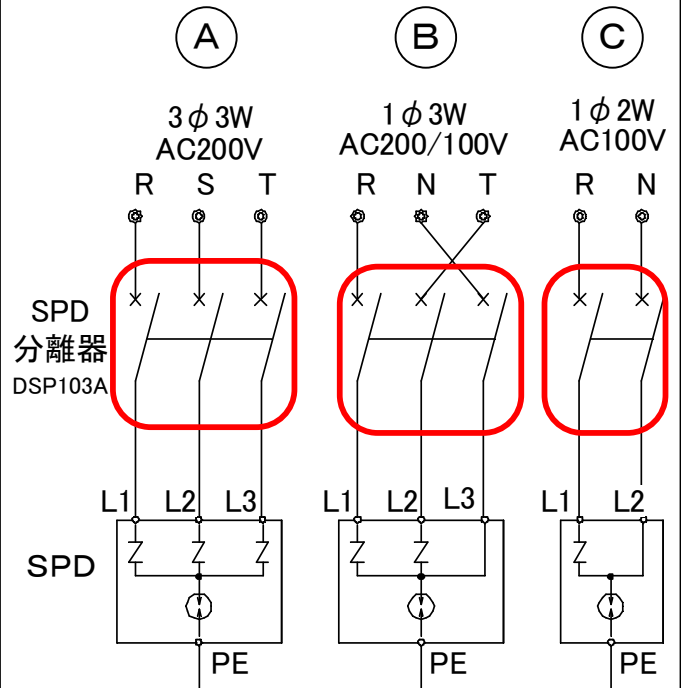
分離器搭載 SPD盤

【内観】



ME-SB30型

【回路図】



【特徴】

1. SPD分離器 (DSP103A) を搭載
2. 配線材料及び配線長の最適化



SPDの性能を最大限に発揮

【特性】

型式	電圧防護レベル Up (Iimp)	インパルス電流 Iimp (10/350 μs)	回路図	外形寸法
ME-SB02型 (1Φ2W)	<1.7KV	25KA	Ⓒ	W350 x H500 x D200
ME-SB03型 (1Φ3W)			Ⓑ	
ME-SB30型 (3Φ3W)			Ⓐ	
ME-SB32型 (3Φ3W+1Φ2W)			Ⓐ+Ⓒ	W450 x H500 x D200
ME-SB33型 (3Φ3W+1Φ3W)			Ⓐ+Ⓑ	

<販売店>

<問合せ先>

HARD PRODUCE

MAESYOU
株式会社 マエシヨウ

Smile Spirit Company



Reg.No.:2006/314

〒447-0854 愛知県碧南市須磨町1番地32
TEL (0566) 48-3636 代
FAX (0566) 48-5485
E-mail: info@maesyoyou.co.jp
URL http://www.maesyoyou.co.jp

SPD分離器(DSP103A)の特徴

●ヒューズ

< デメリット >

- ・10/350 μ S 20KAはもたない
- ・予備ヒューズが必要

< メリット >

- ・インピーダンスが少なく、25KA通過時でもUpが0.01KV以下である

●MCB

< デメリット >

- ・建築設備設計基準にてクラス I は225AF/225ATとなっており、主幹との保護協調がとれない
- ・MCB自体が不要動作、破損の恐れがある
- ・インピーダンスが大きく、25KA通過時ではUpが1KV以上になってしまう

< メリット >

- ・予備ヒューズが不要

●SPD分離器(DSP103A)

< メリット >

- ・単独で10/350 μ S 40KAに耐えられます
- ・インピーダンスが少なく、25KA通過時でもUpが0.01KV以下です
 - ヒューズ同等
- ・商用周波数では5Aでトリップするため、主幹との保護協調もとれます
- ・予備ヒューズも不要
- ・オプションにてアラーム出力も可能
- ・テストボタンによる動作チェックも可能